

# 苏州国芯科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，遵循以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，以上市公司高质量发展为基础，切实履行上市公司的责任和义务，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国芯科技”）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：

### 一、聚焦主营业务，实现高质量发展

国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司为客户提供 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要应用于信创和信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。公司提供的 IP 授权与芯片定制服务基于自主研发的嵌入式 CPU 技术，为实现三大应用领域芯片的安全自主可控和国产化替代提供关键技术支撑；公司的自主芯片及模组产品以汽车电子、信创与信息安全类为主，聚焦于汽车电子、工业控制和边缘计算等关键领域。公司建立了成熟、可复用、易拓展的 SoC 芯片设计平台，公司全面掌握嵌入式 CPU 的微架构自主设计技术。

面对国产替代和半导体芯片自主可控以及 AI、新能源汽车不断崛起带来的发展机遇，我们坚定不移地聚焦主营业务，以市场、客户需求为导向，强调技术的前瞻性和创新性，聚焦研发基于 RISC-V 架构的具备较强实时处理能力 CPU 和高算力 CPU、满足 ISO26262 功能安全的设计技术、边缘 AI 技术和量子安全技术，不断推出新产品，全力补足拓展市场能力，提升品牌形象，推进募投项目建设，致力于实现高质量发展，保持行业内的领先地位。

#### （一）积极研发新产品

##### 1、汽车电子和工业控制领域

国芯科技基于 C\*Core CPU 耕耘汽车电子芯片 14 年，截至 2023 年年底已全面布局了汽车车身和网关控制芯片、动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、数模混合信号类芯片、主动降噪专用 DSP 芯片、

安全气囊芯片、线控底盘芯片、仪表芯片、辅助驾驶芯片和智能传感芯片等 12 大类系列化汽车电子芯片，产品受到包括国际 Tier1 模组厂商和主要汽车主机厂的高度认可，中高端 MCU 在功能和性能方面逐步实现了对国外芯片产品的覆盖，规模化应用达到数百万颗，同时在以安全气囊点火芯片为代表的混合信号芯片方面获得了上车应用突破。

2024 年，公司将进一步增强产品的丰富度，尤其在域控制器、电机驱动、发动机、新能源电池管理、线控底盘、安全气囊点火控制、DSP 主动降噪等应用领域应对客户要求不断优化和细化产品型号，提高产品质量及软件生态丰富度，同时全力推进已量产汽车电子芯片的市场开拓和装车。2024 年，公司继续在高端 MCU 和数模混合信号芯片方面加大研发，并计划于年内推出高集成度的域控制器/ADAS 功能安全控制器 MCU CCFC3012PT，采用多核 PowerPC 架构（6 个主核+4 个锁步核）的公司自研 CPU 核 C3007，算力可以达到 2700DMIPS 以上，兼具功能安全和信息安全处理的功能。公司还正在开发 CCFC3009PT 芯片，这是针对未来汽车电子 SoC/MCU 芯片算力提升的需要，采用高性能 RSIC-V 架构 CPU，算力可以达到 6000DMIPS 以上。同时在混合信号执行器应用领域推出集成度更高的线控底盘控制驱动类芯片和门控领域的控制预驱类芯片，进一步研发推出集成 MCU 和 BLCD 无刷电机驱动功能的单芯片。公司还会加强在汽车智能传感器方面的研发投入，首先开发用于安全气囊的加速度传感器芯片，满足 ASIL-D 功能安全等级，未来可与公司已大规模量产装车的安全气囊控制 MCU 以及开始装车的安全气囊点火驱动专用芯片 CCL1600B，组成方案套片，为客户提供更高 BOM 性价比的安全气囊电子系统解决方案。

围绕前述 12 条产品线，公司将继续坚持“顶天立地”和“铺天盖地”的发展战略，抓住我国汽车电子芯片国产化替代的历史机遇，推进资源优化和聚焦，注重产品技术平台化和系列化，为汽车行业提供更先进、安全可靠的解决方案，为汽车电子芯片国产化做出更大贡献。

## 2、信创和信息安全领域

国芯科技为国内极少数拥有“云-端”安全芯片及模组产品的厂商，处于国内领先地位，部分产品比肩国际一线水平。2023 年，信息安全行业竞争加剧，下游客户需求相对疲软，叠加集成电路行业进入去库存周期，给公司的市场拓展

带来了一定压力。面对上述困难，公司迎难而上，在充分市场调研的基础上，加强市场开拓工作，加快性价比更高产品的推出速度，引入有实力、竞争力的方案商，共同开拓新领域、新市场，加快具有较高技术含量的高端芯片产品研发，持续推出护城河更宽的产品。

2024 年，公司将紧紧抓住数字技术高速发展带来的历史机遇，不断推出更多的“云”“边”“端”信创和信息安全芯片及模组产品。2024 年，面向人工智能和云计算安全、网络安全、高性能网关防护，公司研发新一代云安全计算芯片，主处理器采用高算力 RISC-V 架构的 CRV7AI，并融合了神经网络计算的 AI 协处理单元，可以适应更多高性能计算、高性能处理和人工智能推理等复杂应用场景。产品具备了高安全性、高可靠性以及高扩展性，总体性能具有行业领先水平，可以适用于各种对安全、性能和稳定性要求高的场合，具有较大的产品应用覆盖面。另外，面向海量数据存储、AI 计算加速、企业关键应用、边缘计算、视频流媒体和网络应用等服务器产品，特别是信创领域相关服务器产品，根据客户需求研制高可靠的大容量存储阵列管理整体解决方案，公司基于第一代 RAID 芯片 CCRD3316 继续完善全国产 RAID 卡 CCUSR8116 产品，实现同类产品的全国产化替代，同时将继续研发新一代 RAID 芯片，芯片基于高性能 RISC-V 处理器，采用三模 SerDes 技术，可实现 SAS、SATA 和 NVMe 存储设备的无缝连接设计，未来可以实现对目前服务器市场上国外主流 RAID 芯片的国产化替代。在量子技术方面，实现现有安全模组的量子技术安全升级。国芯科技将与合作伙伴一起在物联网、云计算、先进存储、智能终端等领域，联合开展量子芯片的研发和产业化工作，实现公司现有的信创和信息安全芯片或模组的迭代升级。

## **（二）提升科技创新，发展新质生产力**

2024 年，国芯科技将继续在边缘 AI 技术和量子安全技术方面保持稳定的研发投入，并根据应用需求大胆创新，特别是在交叉领域的集成创新上，将研究成果应用到现有的汽车电子和工业控制芯片产品、信创和信息安全芯片产品上。

### **1、边缘 AI 技术**

边缘 AI 是智能化发展的趋势，是边缘计算和人工智能的结合，可以在没有网络连接的情况下对数据进行处理，具有低延迟、高速处理数据的显著优势，以往很多难以在云端进行数据处理的场景，如工厂机器人、自动驾驶等，都可以通

过边缘 AI 迎来新的技术和应用场景突破，有望加速万物智能时代的到来。

国芯科技与香港应科院合作，建立“香港应科院-苏州国芯新型 AI 芯片联合研究实验室”，合作研发下一代 AI 芯片以及神经网络处理器等产品，该技术将用于公司的汽车电子、工业控制和机器人应用领域的 AI 芯片开发。

## 2、量子安全技术

随着量子信息领域研究的深入和量子计算机研制进度的推进，传统密码学越来越无法满足后量子时代的安全需要，广泛使用的 RSA、ECC 等公钥密码体制将处于危险状态，因此利用量子安全技术重构现有信息安全的密码体系已成为未来信息安全产品的必然趋势。量子安全技术的实现方式目前主要分为两类：（1）后量子密码（PQC）；（2）量子密码（Quantum Cryptography）。公司已在这两类量子安全技术方面进行研发。

在后量子密码（PQC）方向，公司加强 PQC 方面的密码工程化实现技术研发，包括高性价比的后量子密码算法 IP 研发、后量子密码抗侧信道攻击和防护技术研究以及相应 IP 研发。公司预计在 2024 年内完成支持后量子密码算法的 SoC 设计验证工作。

在以量子物理原理为依托的量子密码方向，公司与安徽问天量子科技股份有限公司和合肥硅臻芯片技术有限公司分别组建了量子芯片联合实验室，围绕着量子随机数发生器、量子密钥分发等量子技术和传统芯片、智能终端行业的有机结合，开发适于“量产”的量子安全智能终端可用芯片及设备。

### （三）全力拓展市场，提升品牌形象

2023 年，公司及子公司先后荣获 2023 中国上市公司创新奖、江苏省科技进步三等奖、第十届汽车电子创新奖、工控中国优秀产品奖 TOP10、工控中国 ICSC 风云企业、江苏省现代服务业高质量发展领军企业、2023 年度优秀密码应用方案奖、同花顺最具人气上市公司 TOP100、2022 年度苏州市推动数字经济时代产业创新集群发展工作先进集体等奖项。同时，公司为了更好地进行品牌宣传，向潜在合作伙伴展示新的产品、技术或服务，拓展市场空间，提升市场知名度，公司 2023 年参加了包括商用密码大会、Elexcon 深圳国际电子展、AUTO TECH 等重要行业展会，并协办了第十九届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛。此外，公司积极参与了中国汽车芯片产业创新战略联盟的相关活动，并通过媒体宣传展示

了公司在汽车芯片领域的创新能力。

2024 年，公司将继续加强销售团队和技术服务支持团队建设，特别是加强关键市场负责人员和骨干市场成员的能力培养与团队建设，快速聚焦公司资源，快速响应客户需求，切实提升服务客户的质量和效率。2024 年，公司会进一步巩固核心市场、核心客户、重点客户，确保公司营收目标达成。在服务好原有客户的基础上，采取多元化的销售策略，加强重点领域头部客户的拓展工作，特别是要强化汽车电子和信息安全客户的开拓力度，力争进一步扩大批量供货客户的数量和规模，实现汽车电子、信创和信息安全市场占用率进一步提升，促进公司业务进一步发展。同时，公司将加强对客户的梳理和筛选，优化大客户和优质客户服务，增强客户粘度，拓宽产品应用领域，促使公司产品的市场规模不断扩大。在定制芯片领域，公司将在继续做好定制设计服务的同时，重点加强定制量产服务的业务发展质量和水平，注重挖掘和培育人工智能领域头部客户的定制服务，为公司的人工智能业务的发展奠定基础。

2024 年，公司将进一步加强品牌宣传力度，夯实公司品牌与产品的美誉度，提升公司在资本市场和半导体行业内的知名度，维护公司品牌和产品的良好形象，持续推动产品质量和服务质量的提升，从而推进公司的高质量可持续发展。公司将通过参加行业展会、参加或举办行业论坛、拜访客户、市场调研等方式，及时掌握 CPU 及芯片行业前沿信息，充分了解客户需求及市场最新动态。公司 2024 年拟参加深圳国际电子展&嵌入式系统展、世界新汽车技术合作生态展、北京国际车展、慕尼黑电子展等国内外重要展会，将继续参加泰达国际论坛等产业交流活动，积极对外展示公司最新的芯片产品解决方案、最新成果和创新实力，加强与行业内的交流与合作，进一步拓展国内与国际市场。公司还将与业界专家、学者和企业代表共同探讨行业发展趋势和技术创新方向，为公司的发展提供有力支持。

#### **（四）推进募投项目建设，保障公司发展**

2023 年，公司继续积极开展“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”、“基于 C\*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目”、“基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目”等项目的建设，顺利完成了“基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目”的建设。

2024 年，公司将在充分考虑市场情况、技术发展的背景下，及时进行产品研发，确保资金按照项目需求及时投入，加强项目监督和评估，积极推动募投项目的实施，确保“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”和“基于 C\*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目”按期于 2024 年 10 月达到可使用状态。

公司在苏州市高新区狮山总部产业园-上市企业总部园 K 地块购置的 9 号楼已完成合同签约，大楼作为公司新的总部所在、新的办公和研发基地，将于 2024 年完成建设并使用。新的场地将有望进一步改善办公环境，提升对行业专业人才的吸引力，增强员工归属感，为公司进一步扩展研发空间、提升研发能力提供有力支撑，进一步提升公司创新能力。

## **二、加强内部管理，提升经营效能**

公司致力于构建科学、高效的管理体系，注重内部管理的优化和团队建设，为企业的长效经营、长远发展奠定坚实基础。2024 年，公司将持续优化财务管理、生产管理，加快创新成果转化，加强人才团队建设，持续提升企业的运营水平和竞争力，以强大的团队创新活力与攻坚克难能力共同推动企业发展。

### **（一）优化财务管理**

财务管理作为公司管理的重点内容，2024 年公司将继续优化财务管理工作：

1、公司将进一步优化生产成本管理，加强库存盘点核查、并进行盘盈盘亏分析，细化成本核算、准确核算各类存货成本；加强财务成本分析，全面分析影响成本变动的各类因素，并对主要因素进行重点分析，提出改进措施，促使公司成本水平不断降低；优化预算管理，对生产成本进行事前、事中、事后全过程控制；加强内部审计工作，确保成本控制的规范性和有效性。

2、进一步优化存货管理，规范订单审批流程，严格管控备货水平；并通过制定切实有效的销售计划，加快去库存进度，提高存货周转率，提高经营效率；通过优化 ERP 系统参数，进一步准确核算存货库龄；从严进行跌价测试，规范会计核算，合理反映存货价值；加强存货实物管理，按产品类别放置存货，及时处置不良品；加强存货出入库登记管理工作，通过在货物上粘贴相关标签，保证存货状态、库龄账实相符。

3、进一步优化销售管理，根据市场情况与商业策略进行价格动态调整，并针对不同业务领域、不同类型客户设立合理的价格策略，满足不同客户群体的需

求，扩大客户基础；进一步建立良好的催收流程，提高应收账款周转率，加快资金周转；定期对主要客户进行信用评估，降低企业的交易风险，降低应收款坏账率；加强销售成本的控制，通过优化销售流程、降低销售费用、优化销售团队激励政策等方式，更好地控制销售成本，提高经济效益。

4、进一步优化采购管理，严格规定采购审批流程。加强与供应商的合作与沟通，通过谈判和采购策略的优化调整，降低采购成本，提高采购效率；通过与供应商协商合理的付款方式和期限，优化资金结构，降低筹资成本；进一步加强供应商管理，定期评估供应商的质量、交期、价格和服务水平，确保采购渠道的稳定可靠。通过采购预算和采购计划，严格控制采购成本，加强审核各环节单据，监察价格变动情况，及时掌握成本变化情况。

## **（二）优化生产管理，提升产品质量**

2023年，公司积极加强产业链上下游的管控，各项业务的产能稳定，特别是对汽车电子产品，公司持续提升产品质量，保障了公司业务的正常发展。

2024年，公司将持续提升生产质量，根据市场订单或预测，精心规划投产安排，以确保生产流程高效运转。在质量管理方面，我们将进一步强化过程控制，严格把控每一个生产环节，并进一步加强供应商的质量管控，确保产品质量的稳定性和可靠性。在产能方面，我们将加强产业链协同，深化与上下游企业的合作，保证晶圆制造、芯片封装测试以及原材料的供应稳定，并且定期将产能需求更新给供应商，使之做好产能准备以应对市场的快速变化。同时，公司将进一步优化生产流程、提高生产效率，以保障订单的准时交付。通过这些措施，全面提升公司的产品品质和生产效率，为公司实现可持续发展奠定坚实基础，支撑公司的业绩和市场竞争力的提升。

2024年，针对汽车电子芯片，公司将持续完善质量管理体系和内控流程，对涵盖汽车电子芯片产品的设计开发、生产、测试、检验、包装、储存、运输、变更控制等过程的质量管理进行不断优化，特别是会进一步优化汽车电子 APQP 流程，新建及优化质量文件，完成 PLM 上线。公司持续强化产品质量主体责任，进一步健全产品质量管理体系，加大对供应厂商的管理力度，持续月度评审车规供应商，现场稽核供应商，保障供应链有效运转，积极提高产品良率，确保公司产品的质量，防范企业风险，确保公司可持续发展。公司设有专门的质量部门和

人员对包含汽车电子芯片在内的产品进行质量管理，先后通过了多家 Tier1 模组厂和主机厂的审核，公司未来将进一步加强产品质量建设，做一个让客户信赖的企业。

### **（三）加快创新成果转化**

在当前我国实施创新驱动发展战略的过程中，企业技术创新离不开知识产权保护。截至 2023 年底，公司累计有效专利 143 项（其中发明专利 135 项、实用新型 5 项、外观专利 3 项）、累计有效软件著作权 172 项、有效集成电路布图 31 项、商用密码证书 45 项。

结合我国集成电路产业转型升级和提质增效需求，国芯科技将在 2024 年致力于打好关键核心技术攻坚战，抢占未来产业发展制高点，主动谋划、部署一批适应我国重点领域和重点市场需求急需发展的关键技术和拳头产品，推动我国芯片国产化发展进程。国芯科技将立足于长期主义，将在国产芯片领域继续坚持“顶天立地”和“铺天盖地”的发展战略，通过加快产品迭代，加宽产线布局，抓住我国芯片产业自主可控和国产化替代的历史机遇，加速发展形成“芯”质生产力。2024 年，公司将进一步加强企业知识产权保护，充分发挥知识产权在科技成果转化中的重要作用，促进技术成果转化，让更多创新链的“好技术”变成产业链的“新应用”，实现技术创新与产业提质的同频共振。

### **（四）加强人才团队建设**

2023 年，公司加大了对汽车电子芯片、面向服务器的高可靠存储管理控制芯片（RAID 芯片）的研发投入和市场团队建设，研发费用同比增长 85.36%、销售费用同比增长 47.11%、管理费用同比增长 31.14%；其中研发人员增加 115 人，有力地巩固了国芯科技的研发团队，从而进一步优化公司的人才结构，加强由关键核心技术人员、高层次技术人才组成的研发人才梯队，持续提升研发团队整体素质。

2024 年，公司将继续秉持守正、创新、团结、奋斗的经营理念，加大企业文化建设，营造积极进取、团结协作的工作氛围，增强员工的归属感和认同感，有效激活团队的创新能力、攻坚能力。并通过有针对性的培训和有效的项目考核激励机制，让员工在“能力提升、绩效达成、职业发展”上扮演自主、积极的角色，满足员工个人素质能力的提升和职业发展需求，使企业与员工共同发展，从



而实现企业与员工双赢。

同时，公司基于对未来发展的信心和对国芯科技长期价值的认可，进一步建立、完善公司长效激励机制、充分调动公司员工的积极性，自 2023 年 1 月开始实施上市后的第一期股份回购，至第一期回购期届满，公司已经累计完成 1.82 亿资金的股份回购，回购股份 461.03 万股，所有回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以保持科研团队的稳定。

### **三、强化公司治理与风险管理**

2023 年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

2024 年，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，公司开始修订《公司章程》及修订、制定了部分有关公司治理的 18 项制度，根据相关法律法规赋予独立董事及独立董事专门会议更广泛的知情权和监督权。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，并且通过以业绩为导向的经营目标考核体系，确保经营效益与股东回报相匹配，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。2024 年，公司将进一步完善公司内部治理体系，从上至下强化合规建设，加强内审团队建设，组织董监高等关键管理人员参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各种培训，普及最新法规信息和监管案例，跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。本公司将持续实施“提质增效重回报”的相关举措，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。

### **四、提高信息披露的质量，加强与投资者的沟通交流**

2023 年，公司通过热线电话、现场交流、策略会交流、线上交流、业绩说

明会、上证 e 互动平台、邮箱等各种渠道加强了与各种类型的投资者进行交流，仅 2023 年就与超过 1500 家的投资机构或个人进行了超过 140 场的沟通交流，并及时发布调研记录。

公司与上市公司协会保持了密切沟通联系。2023 年 12 月 12 日上午，中国上市公司协会党委书记、执行副会长柳磊及中上协党委委员、副会长孙念瑞一行带领中上协会会员单位及投资机构，莅临国芯科技走访调研。中上协党委书记、执行副会长柳磊表示，国芯科技作为 2022 年 1 月上市的资本市场新成员，在研发创新上取得了令人鼓舞的成绩，他鼓励国芯科技积极参与国际竞争，希望在研发创新上再接再厉，继续不断推进上市公司的高质量发展。

2024 年，公司将严格按照《证券法》《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，将信息披露工作落到实处和细节上，特别是进一步优化重大信息内部报送制度和流程，增强保密责任意识和保密流程管控，加强对相关工作人员的培训，积极进行信息披露工作团队建设，不断提高信披工作团队的工作积极性、主动性、专业性和责任意识，坚持结果导向，组织全体董监高定期参加信息披露合规培训，推进董监高和信披工作团队加强自我学习，积极正面问题，持续反思汲取经验教训，不断提高合规意识和对投资者的敬畏之心，努力提高信息披露质量，致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

2024 年，公司将借助业绩说明会、投资者交流会、官方网站、社交媒体等多个渠道，保障所有股东享有平等的知情权，全方位展示公司经营状况和发展前景，并通过邮箱、专线电话和上证 e 互动平台，与投资者继续保持密切沟通，每季度与投资者交流不少于 20 次，积极传递公司的投资价值和战略规划。未来公司将持续丰富投资者沟通渠道，通过文字、图表、图片、视频等多种形式相结合让全体投资者能够及时了解公司的经营情况和投资价值，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解和认同。我们将持续完善投资者意见征询和反馈机制，倾听投资者声音，并在合法合规的范围内做出针对性回应。

## **五、积极实施股份回购，重视投资者回报**

自 2023 年 1 月起，我们已开展 1 期股份回购计划。截至本公告日，该期回购已经结束，公司累计回购股份 4,610,343 股，占总股本的比例为 1.37%，用于

支付资金的总额已达到人民币 182,007,240.76 元。公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，2021 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 60,000,000 元。2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份 1,773,812 股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.25186 元（含税），同时以资本公积向全体股东每股转增 0.402978 股，共计派发现金红利共计人民币 59,999,647.70968 元（含税）。累计向股东派发现金红利（不含回购金额）达 1.1999 亿元。公司 2022 年 1 月首次公开发行募集资金净额为 226,237.61 万元，公司上市以来现金分红与回购金额累计占上市募集资金金额的 13.35%。

2024 年，我们将密切关注资本市场动向，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，结合业务现状、未来发展规划及行业发展趋势，积极推进股份回购，公司和管理团队计划投入资金回购公司股份。经过公司董事长、实际控制人之一郑荏提议，公司董事会已在 2024 年 4 月 18 日通过决议，决定以 3000~4000 万元实施上市后的第二次股份回购。公司将致力于努力给投资者带来长期的投资回报，在符合分红政策和条件的情况，公司积极推进分红事宜，增强投资者价值获得感。

## **六、强化管理层与股东的利益共担共享约束机制**

2023 年，公司已建立了严格的薪酬管理制度，公司为高级管理人员制订了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策，使高管在决策时更加专注公司业务发展情况和公司目标的实现。公司高级管理人员的薪酬由岗位基本（职能）工资、绩效奖金组成。岗位（职能）工资综合考虑了岗位的重要性、岗位责任大小、岗位任职资格与条件、岗位职责、职务高低、专业化程度、勤勉用心程度、对公司的贡献程度、市场同行薪资等，个人绩效亦根据高管的个人工作情况与业绩目标完成情况等多方面综合进行评定。

2024 年，公司将积极进一步优化管理层薪酬与激励机制，适时推出股权激励计划，促进管理层与股东利益的深度融合，并努力推动企业高质量发展，严格执行股东回报规划及利润分配政策，根据公司所处发展阶段，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡。公司将全力做好主营业务，努力提升市场份额和经营质量，持续打造产品领先、技术领先的竞争能力，努力以良好的业绩回报广大投资者，

实现社会贡献、股东利益和客户价值最大化的有机统一。

### **七、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2024年4月25日